



中華民國專利證書

發明第 I 244741 號

發明名稱：具金屬塊形電接觸端子電路元件之平片型封裝及其製作方法

專利權人：典琦科技股份有限公司

發明人：陳文隆、胡志良、陳炳南、梁明忠

專利權期間：自2005年12月1日至2023年11月10日止

上開發明業經專利權人依專利法之規定取得專利權

經濟部智慧財產局局長

蔡練生

中華民國

94



12月1日

注意：專利權人未依法繳納年費者，其專利權自原繳費期限屆滿之次日起消滅。